



DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
(art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016)

STRUTTURA: Sezione di Ferrara

DETERMINA n. 306 del 24 maggio 2018

OGGETTO: planarizzazione silicio

RUP: Sig. Stefano Squerzanti

IMPORTO PRESUNTO DELL' ACQUISTO: € 3.000,00 (esclusa IVA)

ESPERIMENTO: DOTAZ. 1

CAPITOLO: U1030102008 Strumenti tecnico-specialistici.

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE:

- o Unico fornitore (allegata relazione)

Data di pubblicazione sul sito www.ac.infn.it - Sezione
"Bandi ed esiti di gara": 01/06/2018

IL DIRETTORE
Prof. Raffaele Tripiccone



Ferrara 24/05/2018

Caro direttore,

l'esperimento UA9 ha la necessità di eseguire la planarizzazione di wafers di silicio di diametro 100 mm tramite fasci di ioni argon. In particolare, si ha la necessità di portare la planarità della superficie dei wafers da circa 2 micron a 0.1 microns su tutta la superficie del wafer. A tal fine, si sono contattate tre aziende (Medialario, Ametek ed NTG), di questa solo l'azienda NTG (Germania) si è resa disponibile. Il costo proposto, di euro 3372+IVA è giudicato congruo alla lavorazione da eseguire.

Il proponente

Andrea Mazzolini

Il RUP

